

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

61191-4

Première édition
First edition
1998-08

Ensembles de cartes imprimées –

**Partie 4:
Spécification intermédiaire –
Exigences relatives à l'assemblage de bornes
par brasage**

<https://standards.iteh.ai>

Printed board assemblies –

**Part 4:
Sectional specification –
Requirements for terminal soldered assemblies**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61191-4:1998

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

61191-4

Première édition
First edition
1998-08

Ensembles de cartes imprimées –

**Partie 4:
Spécification intermédiaire –
Exigences relatives à l'assemblage de bornes
par brasage**

<https://standards.iteh.ai>

Printed board assemblies –

**Part 4:
Sectional specification –
Requirements for terminal soldered assemblies**

© IEC 1998 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

e-mail: inmail@iec.ch

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

Q

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
Articles	
1 Généralités	6
1.1 Domaine d'application	6
1.2 Classification	6
2 Références normatives.....	6
3 Exigences générales	6
4 Exigences générales relatives au montage de bornes et pièces	8
4.1 Préparation des fils et câbles	8
4.2 Installation d'une borne	8
4.3 Montage sur les bornes.....	14
5 Exigences d'acceptation	28
5.1 Contrôle et actions correctives	30
5.2 Brasage de bornes.....	30
5.3 Marquage de pièces et désignations de référence	30
6 Retouche de connexions brasées non satisfaisantes	30

[IEC 61191-4:1998](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/10655269-aabc-4f0b-9801-c5c8bfd62aa/iec-61191-4-1998)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/10655269-aabc-4f0b-9801-c5c8bfd62aa/iec-61191-4-1998>

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
Clause	
1 General.....	7
1.1 Scope	7
1.2 Classification	7
2 Normative references	7
3 General requirements.....	7
4 General terminal and part mounting requirements.....	9
4.1 Wire and cable preparation	9
4.2 Terminal installation	9
4.3 Mounting to terminals.....	15
5 Acceptance requirements	29
5.1 Control and corrective actions	31
5.2 Terminal soldering	31
5.3 Part marking and reference designations.....	31
6 Rework of unsatisfactory soldered connections.....	31

(https://standards.iteh.ai)
Document Preview

IEC 61191-4:1998

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/10655269-aabc-4f0b-9801-c5c8bfd62aa/iec-61191-4-1998>

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMÉES –

Partie 4: Spécification intermédiaire –
Exigences relatives à l'assemblage de bornes par brasage

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61191-4 a été établie par le comité d'études 91 de la CEI: Technique du montage en surface.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
91/135/FDIS	91/147/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La CEI 61191 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: *Ensembles de cartes imprimées*:

Partie 1: Spécification générique – Exigences relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées

Partie 2: Spécification intermédiaire – Exigences relatives à l'assemblage par brasage pour montage en surface

Partie 3: Spécification intermédiaire – Exigences relatives à l'assemblage par brasage de trous traversants

Partie 4: Spécification intermédiaire – Exigences relatives à l'assemblage de bornes par brasage

Cette norme doit être lue conjointement avec la CEI 61191-1.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARD ASSEMBLIES –**Part 4: Sectional specification –
Requirements for terminal soldered assemblies**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61191-4 has been prepared by IEC technical committee 91: Surface mounting technology.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
91/135/FDIS	91/147/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

IEC 61191 consists of the following parts, under the general title *Printed board assemblies*:

Part 1: Generic specification – Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies

Part 2: Sectional specification – Requirements for surface mount soldered assemblies

Part 3: Sectional specification – Requirements for through-hole mount soldered assemblies

Part 4: Sectional specification – Requirements for terminal soldered assemblies

This standard is to be read in conjunction with IEC 61191-1.

ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMÉES –

Partie 4: Spécification intermédiaire – Exigences relatives à l'assemblage de bornes par brasage

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

Cette norme donne des exigences relatives à l'assemblage de bornes par brasage. Les exigences de la présente spécification s'appliquent aux ensembles entièrement constitués d'après des structures d'interconnexion borne/fil et aux portions d'ensembles incluant d'autres techniques associées (par exemple montage en surface, montage par trous traversants, montage à puce).

1.2 Classification

La présente spécification reconnaît que les ensembles électriques et électroniques sont soumis à une classification correspondant à l'utilisation finale prévue pour l'article. Trois classes générales relatives au produit fini ont été établies afin de refléter les différences au niveau de la productibilité, de la complexité, des exigences de performances fonctionnelles et de la fréquence des vérifications (contrôle/essai). Il s'agit de ce qui suit:

Niveau A: Produits électroniques généraux

Niveau B: Produits électroniques spécialisés

Niveau C: Produits électroniques à hautes performances

C'est à l'utilisateur des ensembles que revient la responsabilité de déterminer le niveau auquel le produit appartient. Le contrat doit spécifier le niveau prescrit et indique toute exception ou exigence supplémentaire concernant les paramètres, le cas échéant. Il convient d'admettre d'éventuels empiètements de matériels entre différents niveaux (voir article 4 de la CEI 61191-1).

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61191. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 61191 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 61191-1:1998, *Ensembles de cartes imprimées – Partie 1: Spécification générique – Exigences relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées*

3 Exigences générales

Les exigences de la CEI 61191-1 constituent une partie obligatoire de la présente spécification.

PRINTED BOARD ASSEMBLIES –

Part 4: Sectional specification – Requirements for terminal soldered assemblies

1 General

1.1 Scope

This standard prescribes requirements for terminal soldered assemblies. The requirements pertain to those assemblies that are totally terminal/wire interconnecting structures or to the terminal/wire portions of those assemblies that include other related technologies (i.e. surface mounting, through-hole mounting, chip mounting).

1.2 Classification

This specification recognizes that electrical and electronic assemblies are subject to classifications by intended end-item use. Three general end-product levels have been established to reflect differences in producibility, complexity, functional performance requirements, and verification (inspection/test) frequency. These are the following:

Level A: General electronic products

Level B: Dedicated service electronic products

Level C: High-performance electronic products

The user of the assemblies is responsible for determining the level to which his product belongs. The contract shall specify the level required and indicate any exceptions or additional requirements to the parameters, where appropriate. It should be recognized that there may be overlaps of equipment between level where appropriate (see clause 4 in IEC 61191-1).

2 Normative references

The following normative document contains provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 61191. At the time of publication, the edition indicated was valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 61191 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent edition of the normative document indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 61191-1:1998, *Printed board assemblies – Part 1: Generic specification – Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies*

3 General requirements

Requirements of IEC 61191-1 are a mandatory part of this specification.

4 Exigences générales relatives au montage de bornes et pièces

Les exigences suivantes sont applicables au montage de pièces pour tous les types d'ensembles.

4.1 Préparation des fils et câbles

Une partie suffisante de couverture d'isolant doit être dénudée sur le fil ou les sorties pour respecter les spécifications relatives aux dégagements d'isolation. Les dénudeurs chimiques doivent être utilisés uniquement pour le fil plein et ils doivent être neutralisés ou éliminés avant le brasage. Lors du dénudement de l'isolant, il convient de prendre des précautions afin d'éviter d'entailler ou d'endommager de quelque manière le fil ou l'isolant restant. Pour les ensembles de niveau A ou B, le nombre de brins entaillés ou rompus dans un seul fil ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau 1. Pour les fils utilisés à un potentiel de 6 kV ou plus, ou pour les ensembles de niveau C, aucun brin ne doit être cassé; le nombre de brins entaillés doit correspondre au tableau 1. La décoloration de l'isolant résultant d'un dénudement thermique est permise.

Tableau 1 – Limites relatives aux brins entaillés ou cassés

Nombre de brins	Nombre maximal autorisé de brins entaillés ou cassés	
	Niveau A et B	Niveau C
Moins de 7	0	0
7 – 15	1	0
16 – 18	2	0
19 – 25	3	0
26 – 36	4	0
37 – 40	5	0
41 ou plus	6	0

4.1.1 Etamage de fil câblé

Les portions de fil câblé à braser doivent être étamées avant le montage. La brasure doit pénétrer jusqu'aux brins intérieurs du fil et doit mouiller la portion étamée du fil. L'effet de mèche de la brasure sous l'isolant doit être minimisé.

4.2 Installation d'une borne

Les exigences détaillées relatives à l'installation des bornes par brasure sont définies dans les paragraphes suivants.

4.2.1 Montage de borne (mécanique)

Les bornes non connectées à un câblage imprimé ou aux plans de masse doivent présenter la configuration à bride laminée (voir figure 1). Il est permis d'utiliser une pastille de feuille imprimée comme surface de support pour une bride laminée à condition que la pastille soit isolée et ne soit pas connectée à un câblage imprimé actif ou à un plan de masse.

4 General terminal and part mounting requirements

The following requirements are applicable to part mounting in all types of assemblies.

4.1 Wire and cable preparation

Sufficient insulation cover shall be stripped from the wire or leads to provide for insulation clearances as specified. Chemical stripping agents shall be used for solid wire only and shall be neutralized or removed prior to soldering. In stripping insulation, care should be taken to avoid nicking or otherwise damaging the wire or the remaining insulation. For level A or B assemblies, the number of nicked or broken strands in a single wire shall not exceed the limits given in table 1. For wires used at a potential of 6 kV or greater, or for level C assemblies, there shall be no broken strands. The number of nicked strands shall be in accordance with table 1. Insulation discolouration resulting from thermal stripping is permissible.

Table 1 – Nicked or broken strand limits

Number of strands	Maximum allowable nicked or broken strands	
	Level A and B	Level C
Less than 7	0	0
7 – 15	1	0
16 – 18	2	0
19 – 25	3	0
26 – 36	4	0
37 – 40	5	0
41 or more	6	0

4.1.1 Tinning of stranded wire

Portions of stranded wire which will be soldered shall be tinned prior to mounting. The solder shall penetrate to the inner strands of the wire and shall wet the tinned portion of the wire. Wicking of solder under the insulation shall be minimized.

4.2 Terminal installation

The detailed requirements for installation of solder terminals are defined in the following paragraphs.

4.2.1 Terminal mounting (mechanical)

Terminals not connected to printed wiring or ground planes shall be of the rolled flange configuration (see figure 1). A printed foil land may be used as a seating surface for a rolled flange provided that the land is isolated and not connected to active printed wiring or ground plane.